

HiBy R6 Pro 製品仕様

ハードウェア仕様

CPU モデル

Snapdragon 425 SoC

CPU コア

Quad Core A53

CPU クロック速度

1.4GHz

拡張タイプマイクロ SD カード最大サイズ

2TB

DAC

ESS9028Q2M×2 個 (各チャンネル用)

I/V

MUSES8920×4 個

LPF&Amplifier

SSM6322×2 個

水晶

低位相ノイズ水晶×2 個

RAM

3GB

ストレージ

32GB

接続とディスプレイ

WI-FI

2.4GHz/5GHz

Bluetooth

Bluetooth V4.0、aptX 対応

USB インターフェース

USB タイプ C、双方向 USB DAC

HiBy APP

LAN、DropBox、DLNA をサポート

UI

Android 8.1

ディスプレイサイズ

4.2 インチフルタッチスクリーン (コーニング社製ゴリラガラス)

画面タイプ

IPS TFT
画素密度
320PPI
解像度
1280*768
最大表示色
1600 万色

ボタンとポート
ボタン
サイドボタン+タッチスクリーン
ヘッドフォン出力
3.5mm ヘッドフォンジャック
バランス出力
4.4mm5 極ヘッドホンジャック
ライン出力/デジタル同軸出力
3.5mm ポート (共有 LO /同軸出力)
ゲインコントロール
DSD+6dB TGC
High and Low, 2-level
DSD サポート
DSD256 まで
PCM サポート
384kHz/32Bit まで
駆動能力
8-150Ω (推奨)
USB 接続
USB タイプ C (QC3.0 /データ転送)

電源と一般
充電インターフェース
USB-TypeC
USB 電源アダプタ
DC5V~9V
電池
4000mAh リチウムポリマー
電池充電時間
70% 60 分 (QC3.0)
100% 140 分 (QC3.0)

ボディ素材

316L ステンレススチール

イコライザ

10 バンド EQ (±12dB)、8 プリセット+カスタムプリセット

データ転送

USB2.0

ファームウェアのアップグレード

SD カード (FAT32 システムのみ) または Wi-Fi 経由 OTA でサポート

製品の重量

285g

製品寸法

119.8×66.96×15.7 mm

ロスレス形式のサポート

DST ISO

DSD : DSD64/128/256 (".iso", ".dsf", ".dff")

DXD : 352.8K

APE FAST/High/Normal : 384kHz/24bit (MAX)

APE Extra High : 192kHz/24bit (MAX)

APE Insane : 96kHz/24bit (MAX)

Apple Lossless : 384kHz/32bit (MAX)

AIFF : 384kHz/32bit (MAX)

FLAC : 384kHz/32bit (MAX)

WAV : 384kHz/64bit (MAX) WMA LOSSLESS : 96kHz/24bit (MAX)

ロッキー形式

MP3、AAC、WMA、OGG 等

オーディオ仕様

シングルエンドヘッドフォン出力 (3.5mm)

出力電力

245mW (RMS) @32Ω

ノイズフロアレベル

3.8uVrms

周波数応答 (±3dB)

20-90000Hz

SNR

131dB

チャンネル分離

68dB

THD +ノイズ

0.0025%

出力インピーダンス

0.24Ω

バランスヘッドフォン出力 (4.4mm)

出力電力

750mW (RMS) @32Ω

ノイズフロアレベル

5uVrms

周波数応答 (±3dB)

20-90000Hz

SNR

133dB

チャンネル分離

97dB

THD +ノイズ

0.0012%@ 1mW

出力インピーダンス

0.28Ω

ライン出力 (3.5mm)

出力電力

2Vrms

ノイズフロアレベル

2.6uVrms

周波数応答 (±3dB)

20-90000Hz

SNR

122dB

チャンネル分離

109dB

THD +ノイズ

0.0023%

出力インピーダンス

10KΩ

